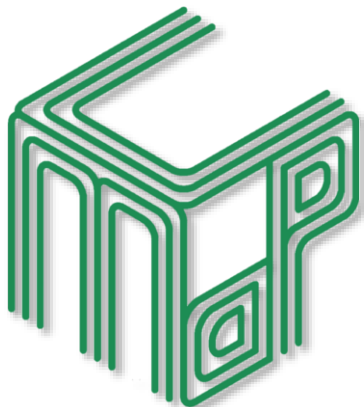




U-MAP Co.,LTD

Ultimate Material and Processing

CEO 西谷健治
nishitani@umap-corp.com

Value Proposition (提供价值)

源自名古屋大学的
材料创业公司



实现电子器械的热控制
的最优的放热材料

以最先进的技术开发
世界上独一无二的热传导材料
"Thermalnite"

Big Idea



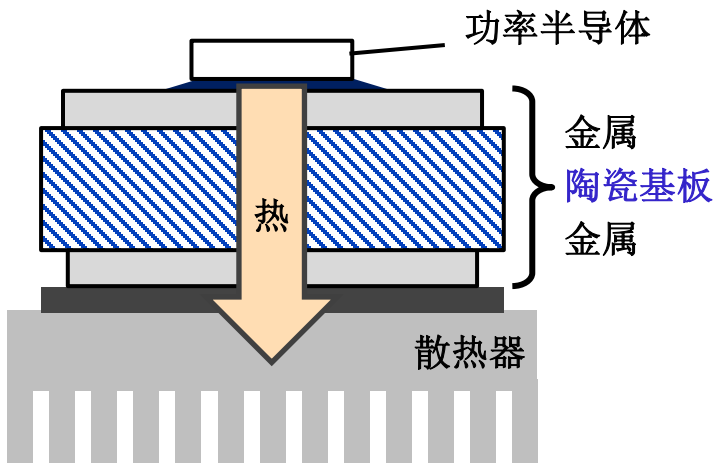
机器的“热” 由材料控制

- ✓ 更高的输出
- ▶ ✓ 更长的寿命
- ✓ 更强的节能效果

Problem (问题)

设备零件的高散热是一个亟待解决的问题

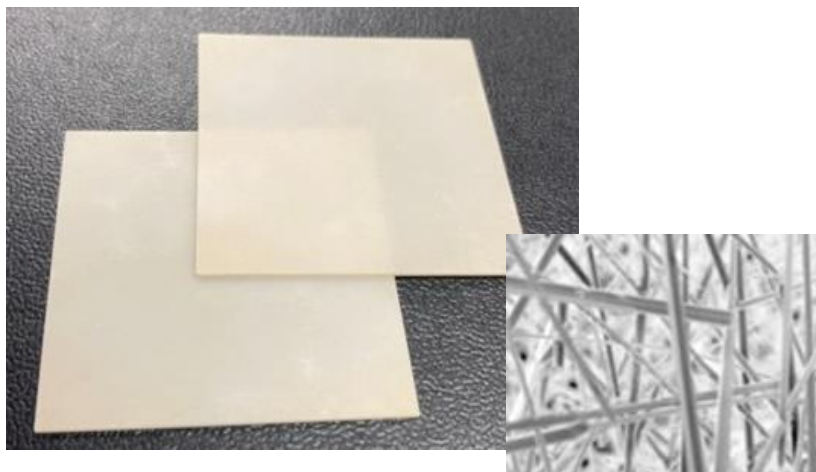
功率模块示例图



陶瓷基板是影响
放热性能的重要因素

Benefits (技术指标)

Thermalnite添加
氮化铝基板

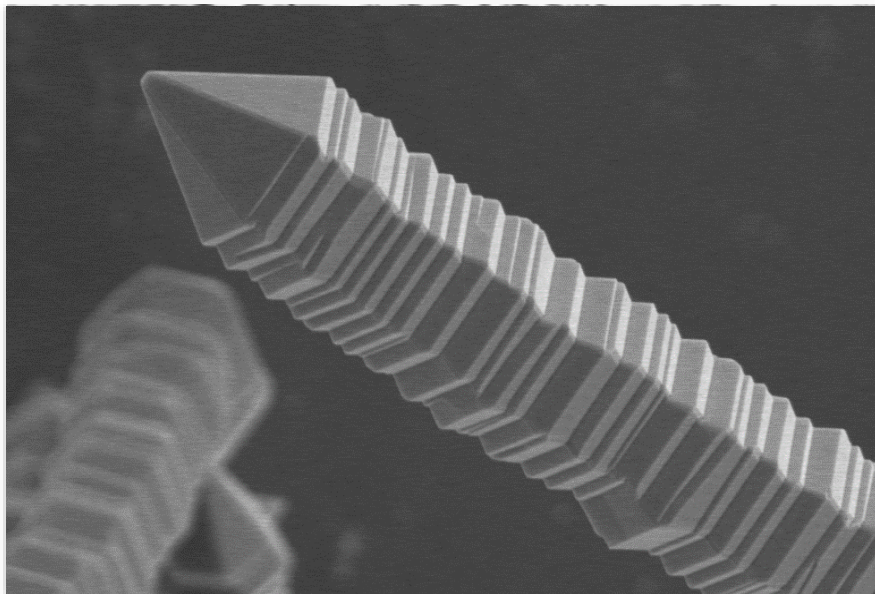


Thermalnite

- ✓ 高放热性
- ✓ 高强度
- ✓ 更薄/更轻

Thermalnite®

世界独一无二的原创技术



Competition (竞争优势) 陶瓷基板

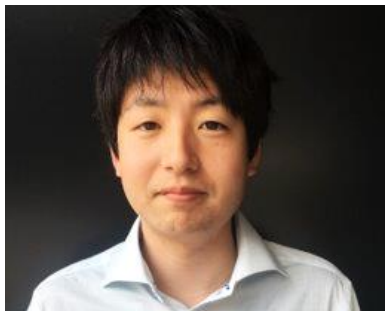


Technical Evidence(技术指标)

陶瓷基板的特性比较

	热传导率 [W/mK]	机械特性 (断裂韧性) [Mpa · m ^{1/2}]
氮化硅 (Si ₃ N ₄)	×	○
氮化铝 (AlN)	○	×
Thermalnite添加 氮化铝 (AlN)基板	◎	◎

Team board member (核心团队)



西谷 健治
(CEO)
名古屋大学大学院
材料工学研究科
硕士



前田 孝浩
(COO)
日立国际电气
半导体制造技术开发
株式会社三幸 董事



宇治原 徹
(CTO)
名古屋大学
未来材料系统研究所 教授
産業技術総合研究所 副所长

Traction (成绩)



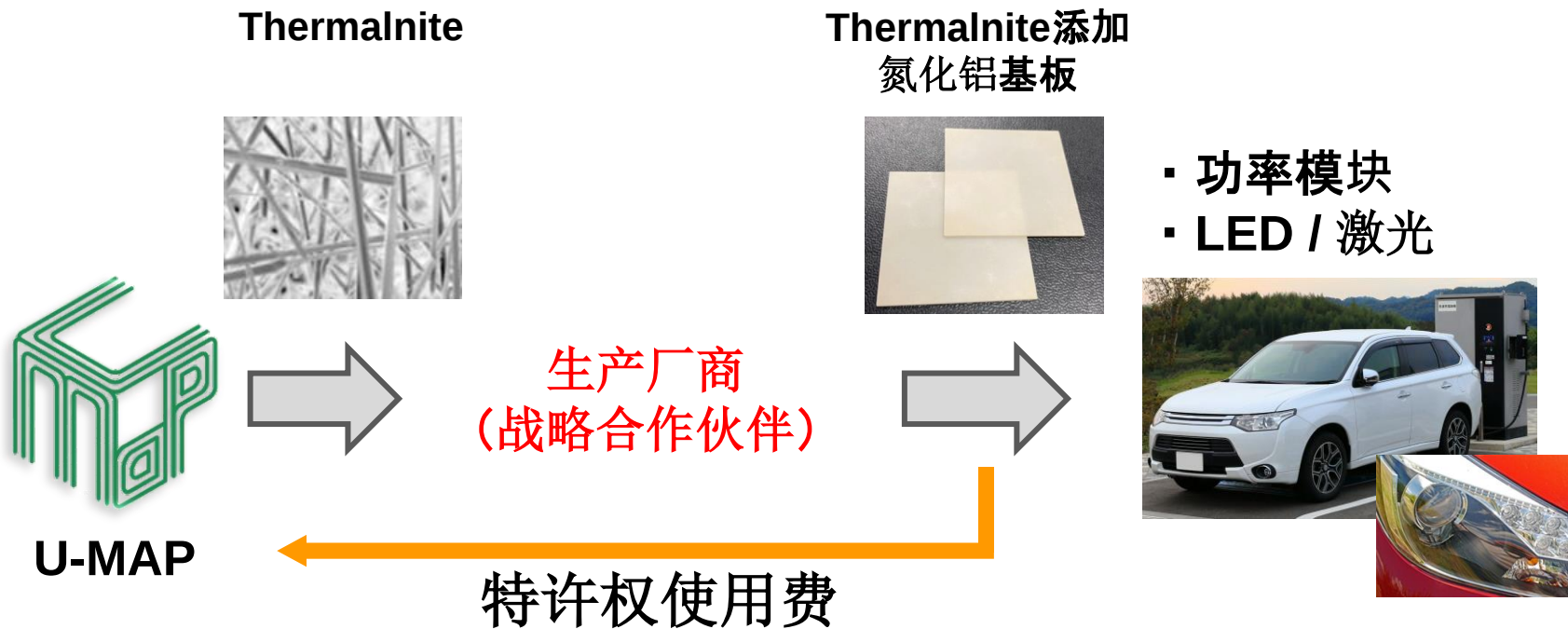
样本销售
5000万日元 (300万元) 以上

政府补贴等
2億日元 (1,200万元) 以上



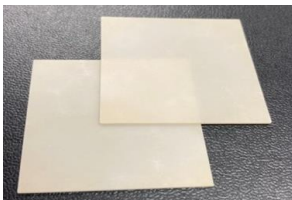
ILS Award
[最优秀特等奖]
CNB Venture大賞
[最优秀奖]
Deep Tech Grand Prix
[最优秀奖]

Business Model (商业模式)



For Chinese Market (中国市场)

扩大在中国的销售渠道



海外网络

建立供应链

与EV/5G设备厂商合作
一起建立供应链

战略合作伙伴

建立联盟

与陶瓷厂商合作

Contact Info (联系方式)



Business Card

nishitani@umap-corp.com



LinkedIn

[https://www.linkedin.com
/company/umap-corp](https://www.linkedin.com/company/umap-corp)

